Dec.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

１．適　用　範　囲

本指定書は、『ＳＭシリーズコネクタ』の実装温度プロファイル、手はんだ条件について規定します。

２．推奨温度プロファイル、手はんだ条件

次頁によります。

注）フロー条件 ⇒ ディップ品、リフロー条件 ⇒ ＳＭＴ品　にそれぞれ適応します。

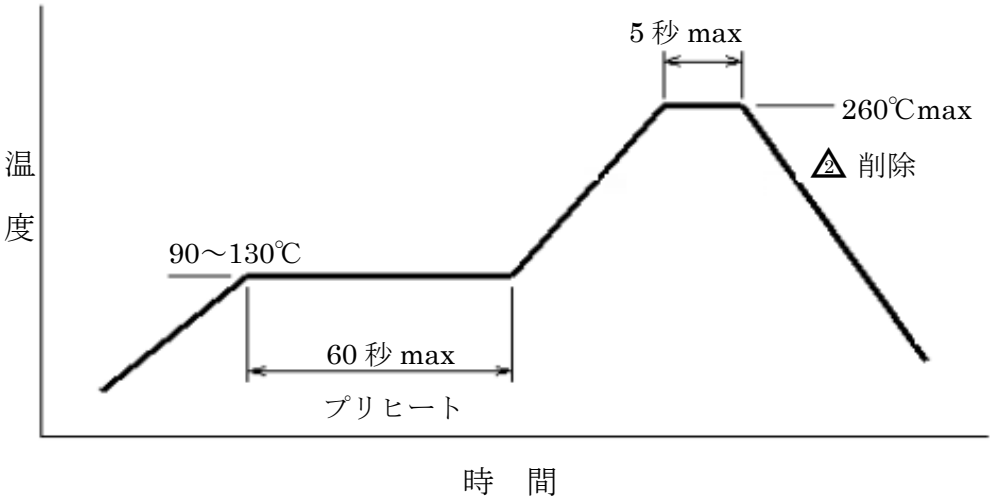
	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
2	2	DIS-E-00006584	KG.OKITA	MN.KENJO	20210811

名　称　TITLE	HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		
SM ｼﾘｰｽﾞ、実装温度ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	APPROVED	HO.MIWA	20070507
	CHECKED	HO.MIWA	20070507
	DESIGNED	SJ.SHIMIZU	20070507
	WRITTEN	SJ.SHIMIZU	20070507
技術指定書　TECHICAL SPECIFICATION	ATAD-E2741-00	2	1/3

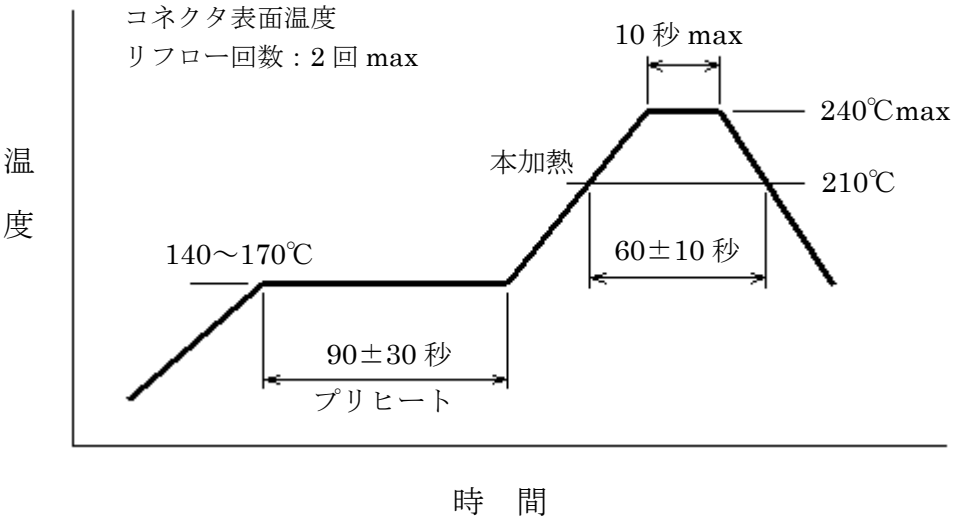
FORM HC0011-9-1

共晶はんだ推奨温度プロファイル、手はんだ条件

◇フロー（Sn-Pb 系はんだを使用）



◇リフロー（Sn63-Pb37 ペーストを使用）



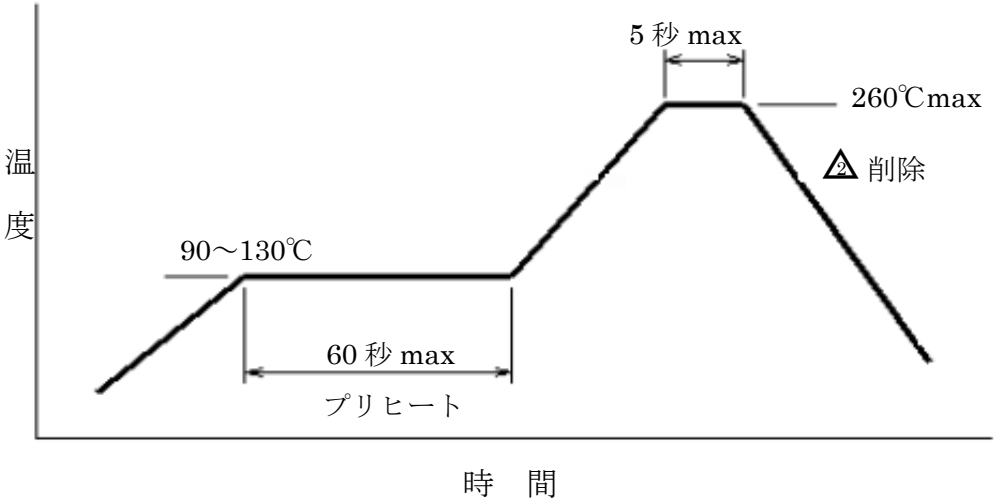
◇手はんだ（Sn60-Pb はんだを使用）

はんだコテ先温度：３５０℃max、はんだ時間：５秒 max

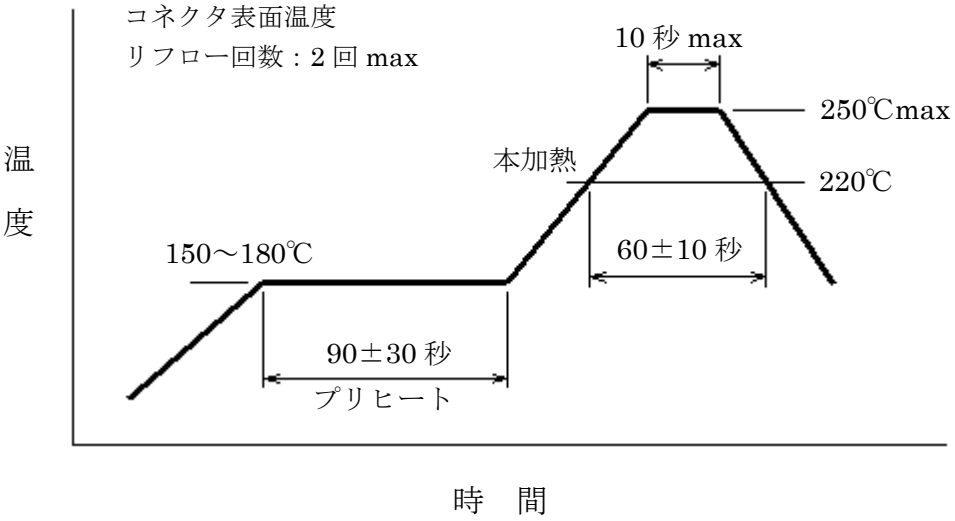
Dec.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

鉛フリーはんだ推奨温度プロファイル、手はんだ条件

◇フロー条件（Sn-Ag-Cu 系はんだを使用）



◇リフロー条件（Sn96.5-Ag3-Cu0.5 ペーストを使用）



◇手はんだ条件（Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだを使用）

はんだコテ先温度：３９０℃max、はんだ時間：３秒 max

Dec.1.2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.